

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（下称“公司”）始终践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，为保障公司全体股东的共同利益，基于对公司未来长远发展的坚定信念、对企业内在价值的高度认可以及对社会责任的主动担当，为实现在 2026 年持续巩固现有发展成果，并推动业绩与治理水平进一步提升，于 2026 年 2 月制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。2026 年上半年，公司以该行动方案为指导纲领，扎实推进各项举措落地，在优化运营效能、增强核心竞争实力、维护投资者合法权益以及塑造健康正面的资本市场形象等维度均取得了阶段性积极成果。现将该行动方案的半年度具体执行进展汇报如下：

一、行动方案相关措施的实施情况及效果

（一）聚焦经营主业，深耕半导体专用设备领域

1、深耕专业领域，推动业绩稳健提升

公司长期专注于半导体专用设备赛道，坚持以客户需求为牵引，依托差异化的技术优势，向市场输出专业、稳定、高效且精细化的产品与服务体系。2026 年上半年，公司经营规模持续扩大，业绩较上年同期实现显著增长：2026 年 1-6 月累计实现营业收入 371,809.71 万元，同比增长 13.87%，归属于上市公司股东净利润达 98,894.94 万元，同比增幅为 42.14%。

2、坚持市场开拓与产品矩阵完善协同推进

2026 年 2 月，公司自主研发的最新一代 12 英寸单片清洗系列设备已成功交付并入驻客户位于新加坡的跨国晶圆代工厂，这是公司该类设备首次在新加坡晶圆厂实现落地应用，标志着公司在拓展东南亚半导体市场的重要突破。此外，公司亦斩获全球多家客户的先进封装设备订单，订单产品涵盖新加坡某全球领先封测服务（OSAT）企业的多台晶圆级电镀与湿法设备、中国大陆外某全球头部封

装厂商的一台面板级负压清洗设备，以及北美某头部科技企业的多台晶圆级湿法设备，前两类订单已经于 2026 年上半年交付，后者也将于今年晚些时候交付。此次多区域、多品类设备订单的落地，标志着公司全球化战略布局已初见成效。

2026 年 3 月，公司对公司产品线组合进行重组及品牌焕新，正式发布全新产品组合架构“盛美芯盘”，将产品整合为八大独立系列，覆盖清洗、电镀、涂胶显影、刻蚀及先进封装等多个半导体制造关键环节。通过持续拓展产品品类，公司致力于为客户提供更全面的半导体专用设备解决方案。在产品应用和交付方面，公司自 2017 年首台 Ultra ECP ap 设备进入先进封装客户验证、2019 年成功切入前道 IC 制造，公司电镀业务稳步提速，先后在 2022 年突破 500 腔、2025 年突破 1500 腔交付规模，并于 2026 年 6 月正式迈入 2000 腔量产交付新阶段。

3、坚持差异化创新，继续加大研发投入、人才培育与成果转化力度

2026 年上半年，公司持续聚焦半导体专用设备的制造与研发，不断推进产品技术的升级迭代，保持高强度的研发经费投入，积累并深化工艺技术储备。公司 2026 年 1-6 月研发投入为 66,268.05 万元，同比增加 21.73%，占公司同期营业收入的比例为 17.82%。与此同时，公司高度重视研发人才梯队建设，通过外部招聘与内部培养双渠道，持续壮大技术团队，截至 2026 年 6 月 30 日，公司研发人员数量为 1,297 人，占公司员工总数的 49.90%，较上年末增长了 5.62%。

在专利布局层面，2026 年上半年，公司及控股子公司共申请专利 229 项，新获授专利 46 项。截至 2026 年 6 月 30 日，公司及控股子公司累计申请（含被授权许可）专利 2,633 项，拥有及被许可已获授予专利权的主要专利 646 项（其中发明专利共计 640 项），比上年末增长了 8.21%，其中境内授权专利 245 项，境外授权专利 401 项。

在技术成果应用和“落地”方面，2026 年 4 月，公司首台等离子体增强化学气相沉积（PECVD）碳氮化硅（SiCN）设备正式出机。该设备采用公司自研的沉积架构，在单一反应腔内配置了三个工艺工位，采用旋转沉积的方式实现对界面层形成、气流管理及薄膜均匀性的更精确控制。2026 年 5 月，公司在全球半导体表面制备与清洗会议 SPCC 2026（Surface Preparation and Cleaning Conference）上介绍了公司独特的高温 SPM 工艺，该工艺使得高温 SPM 方案在 15nm 颗粒标

准下，控制水平可低至 15 颗以内，显著优于市场主流方案；加之公司独特的喷嘴设计可有效避免相关污染问题，无需周期性 DI 水清洗即可实现稳定的清洗效果。这一技术性能的跨越式提升，将为 GAA 逻辑器件以及 DRAM/HBM 器件的良率提升带来重要支持。

4、积极推进公司 H 股上市事项

为深化战略布局，开拓国际市场，壮大公司资本规模，持续吸引并聚集优秀人才，进一步提升公司综合竞争实力，夯实国际市场地位，2026 年 6 月 16 日，公司已经 2025 年年度股东会审议通过发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司挂牌上市（以下简称“H 股上市”）的相关议案，正在积极推进 H 股上市相关事宜。

（二）高效利用募集资金并持续推进募投项目

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“盛美半导体设备研发与制造中心”、“盛美半导体高端半导体设备研发项目”、“补充流动资金”和“高端半导体设备拓展研发项目”均已完成投入或达到预定可使用状态，并已于 2025 年 6 月全部完成结项。2026 年上半年，公司审议并完成使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的相关事项。截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2021 年首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，对应募集资金专项账户均已办理完成销户手续。

2、2024 年度向特定对象发行股票募集资金

截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	累计投入金额	投入进度
1	研发和工艺测试平台建设项目	92,234.85	11,917.26	12.92%
2	高端半导体设备迭代研发项目	220,848.65	29,178.24	13.21%

3	补充流动资金	130,418.07	130,399.52	99.99%
合计		443,501.57	171,495.03	-

注：表格中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

公司 2024 年度向特定对象发行股票的募投项目与公司主营业务紧密相连，系公司未来发展的重要基石之一，亦是公司未来发展战略的重要方向，公司将继续积极推进上述募投项目的实施、全面强化对募投项目的管理，力促募投项目早日投产达效，巩固提升科技创新成果。

（三）优化运营管理，强化人才激励

为健全长效激励机制，促进公司、个人与股东利益协同，充分调动员工积极性，2026 年上半年，公司审议通过了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》，该激励计划覆盖 520 名公司员工，包括职工代表董事、副总经理、核心管理（业务）骨干、中层管理（业务）人员、优秀基层技术（业务）员工。此外，公司还完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期第二批次的股份登记工作，激励对象共计 448 人，涵盖董事、高级管理人员、核心技术人员、核心管理（业务）骨干、中层管理（业务）人员及优秀基层技术（业务）员工，认购股票数量为 2,431,900 股，授予价格 48.50 元/股。

（四）完善多市场公司治理制度，推动公司高质量发展

2026 年上半年，为公司 H 股上市之目的，根据境内外有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定以及相关监管要求，结合公司的实际情况和需求，完善多市场的公司治理，公司对 H 股上市后适用的《公司章程》及相关议事规则进行了修订，并梳理更新、制定了其他涉及董事会运作、内部审计、信息披露等十七项内部治理制度。通过本次系统性制度修订与制定，公司进一步优化了董事会架构和决策机制，确保了治理实践与境内外监管要求的全面对接，有效提升了公司整体运作的规范性和治理水平。

与此同时，公司亦不断夯实 ESG 管理水平，积极推动可持续发展。2026 年上半年，国际与中国各大 ESG 评级机构公布了其 2025 年度评级结果，公司在 MSCI ESG Rating、中证 ESG 评级、Wind ESG 评级、中诚信绿金 ESG 评级、华

证 ESG 评级、商道融绿 ESG 评级等各大 ESG 评级体系中的评级整体稳中有升，评级水平持续优化。其中，公司在 Wind ESG 评级由 A 级提升至 AA 级，中诚信绿金 ESG 评级由 A-级提升至 A+级，MSCI ESG Rating、华证 ESG 评级均由 BBB 级提升至 A 级。公司在国际和中国主流 ESG 评级体系中的评分均有显著提高，反映出外界对公司可持续发展实践的积极反馈，也标志着公司在 ESG 治理方面迈上了新台阶，收获阶段性成果。

（五）持续加强投资者沟通交流，提升信息披露透明度

2026 年上半年，公司通过上交所 E 互动平台、业绩说明会、投资者交流会、投资者热线电话、电子邮件等多种渠道，积极与投资者沟通，增强信息透明度和管理规范性，保障广大投资者的知情权，具体包括：

2026 年 1 月 27 日，公司组织了特定对象调研，管理层以现场调研结合电话会议的方式，在信息披露允许的范围内与 25 家国内外机构投资者就公司的经营情况、2026 年营收指引等投资者关注的问题进行了深入浅出的交流。

2026 年 3 月 10 日，公司通过进门财经平台举办了 2025 年度业绩交流会，会上，管理层详细解读了 2025 年全年业绩与财务指标，并与投资者就热点问题展开充分交流，逐一回应。

2026 年 3 月 31 日，公司通过上证路演中心举办了 2025 年年度业绩暨现金分红说明会，公司董事长 HUI WANG、董事兼总经理王坚、独立董事蒋守雷、财务负责人 LISA YI LU FENG、董事会秘书罗明珠参加了会议，公司就 2025 年度经营成果及现金分红方案，与投资者开展了深入的交流与互动，并对投资者提出的相关问题予以充分回复。

2026 年 5 月 14 日，公司通过进门财经平台举办了 2026 年第一季度业绩交流会，对 2026 年第一季度业绩和财务情况进行介绍，并就投资者关心的问题进行了回复。

2026 年 6 月 16 日，公司在临港研发与制造中心成功举办 2026 年投资者开放日活动，当日举行厂房参观、多场投资者交流活动，吸引约 300 位个人投资者、机构投资者与行业分析师现场参与。公司董事长 HUI WANG、董事兼总经理王

坚、副总经理陈福平、财务负责人 LISA YILUFENG、董事会秘书罗明珠等管理层出席活动，并与投资者座谈沟通。活动当天公司向投资者们展示了产品体系及面板级先进封装三款首创设备，介绍公司 2026 年第一季度新订单签署情况、2026 年全年的营收预测情况和市场拓展情况以及公司临港厂房产线的筹备投产情况等。公司将继续坚守“技术差异化、产品平台化、客户全球化”发展战略，持续强化核心技术研发能力，稳步推进订单交付，不断夯实经营基本面、以业绩回馈投资者。

2026 年上半年，公司投资者关系管理成效显著：通过上证 E 互动平台，累计收到并答复投资者提问 18 项，答复率保持 100%。在此基础上，公司以多元化渠道为载体，及时、全面地传递投资价值，依法合规披露经营现状与战略规划，持续深化双向沟通，有效提振市场信任，进而吸引更多投资者，特别是中长期资金参与，为资本市场高质量发展注入动力。

（六）强化回报导向，深挖价值潜力，坚定投资者持股信心

2026 年上半年，公司依据此前制定的《盛美半导体设备（上海）股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》及 HUI WANG 先生的提议，稳步推进 2025 年度利润分配事宜，以强化投资者信心和回报预期。该举措充分体现了公司重视股东利益、坚持成果共享的治理理念，旨在使全体投资者在公司的持续发展中获得切实的价值回馈。

公司于 2026 年 2 月 26 日召开第三届董事会第三次会议，于 2026 年 6 月 16 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 480,164,789 股，以剔除已回购股份 443,400 股后的总股本为基准，拟每 10 股派发现金红利 6.233 元（含税），共计派发现金红利 299,010,341.76 元（含税），本次利润分配现金分红金额占 2025 年合并报表归属于母公司股东净利润的 21.42%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。2025 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 50,012,340.46 元，现金分红和回购金额合计 349,022,682.22 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例 25.00%。考虑到 2026 年上半年，公司完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留

授予部分第一个归属期第二批次的股份登记工作，导致参与本次分红的股数发生变化。公司于 2026 年 7 月 3 日进行公告，将公司 2025 年度利润分配方案调整为：每股派发现金红利 0.62016 元（含税），利润分配总额为 299,012,183.71 元（含税），具体内容详见公司于 2026 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2025 年度利润分配方案每股分红金额的公告》（公告编号：2026-032）。上述权益分派已于 2026 年 7 月 31 日实施完毕，具体详见公司于 2026 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-034）。

（七）深化“关键少数”自律意识，压实风险共担及责任利益共享约束

2026 年上半年，为提升公司董事、高级管理人员的履职能力与自律意识，确保其及时把握最新监管动态，公司积极组织全体董事、高级管理人员参加了由上海证监局指导、上海上市公司协会主办的上市公司董事、高管培训班。通过系统学习《上市公司治理准则》、董事高管履职要点及典型违法违规案例解析，参训人员进一步强化了“关键少数”自律意识、合规边界与责任担当，公司治理质量与规范运作水平在董事、高管的积极履职下再上新台阶。

公司持续推进“关键少数”与中小股东的利益深度绑定，在完善科学绩效考核的基础上，强化公司实际控制人、董事、高级管理人员与公司、中小股东的责任共担与收益共享约束。截至 2026 年 6 月 30 日，上述人员直接持股总数已达 2,499,208 股，较上年末上升 17.58%。该持股变化不仅彰显了内部核心团队对公司未来成长的坚定信心，也向公众投资者传递了利益协同、长期共赢的明确态度。

二、投资者关于改进行动方案的意见建议

无。

三、进一步改进措施

2026 年上半年，公司扎实推进行动方案的全面落地，在运营效率提升、市场

竞争力增强、投资者权益保护及资本市场形象建设等方面均取得了阶段性成果，为公司长远稳健发展奠定了坚实基础。展望未来，公司将继续深化各项既定举措，进一步聚焦主营业务，坚持差异化创新路径，不断夯实核心竞争优势；同时，以更优质的业绩回馈广大投资者的信任，以更高效规范的公司治理树立行业新标杆，持续向高质量发展迈进。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2026年8月6日